

tML® HD - Ein Durchbruch in Sachen Packungsdichte

19.06.2012, 09:22 | IT, New Media & Software

Pressemitteilung von: *tde - trans data elektronik GmbH*

Presseagentur: *epr-elsaesser public relations*



tde - trans data elektronik präsentiert tML® HD Patchkabel und Module für enorme Packungsdichte im modularen System Dortmund, 18. Juni 2012. Als Erweiterung des erfolgreichen Verkabelungssystems tML®-tde Modular Link stellt die tde - trans data elektronik GmbH als führender Hersteller, Distributor und Systemanbieter von Netzwerktechnik und Vorreiter auf dem Gebiet der LWL-Mehrfasertechnologie ein neues, auf dem LC-Steckertyp basierendes LWL-Verbindungskonzept vor, das eine geniale Packungsdichte und einfachstes Handling ermöglicht. Die Stecker lassen sich durch einen neu entwickelten Entriegelungsmechanismus "fingerfrei" aus den Adaptern lösen, das erlaubt die direkte Aneinanderreihung der LC-Adapter übereinander und ermöglicht die Nutzung von 192 Fasern auf einer Höheneinheit.

"Dank des kompakten und platzsparenden Designs des tML® HD Patchkabels können wir im modularen Plug&Play-System tML® statt bisher 96 Fasern künftig 192 Fasern auf einer Höheneinheit unterbringen - die Anwender können also bei gleichem Platzangebot doppelt so viele Ports installieren. Diese Packungsdichte ist derzeit einzigartig in der Branche!", so André Engel, Geschäftsführer der tde - trans data elektronik GmbH.

Gängige LC-Steckverbindungen - Fingerfertigkeit ist gefragt!

Bei herkömmlichen LC-Steckverbindern wird ein Entriegelungsmechanismus nach unten gedrückt, um den Stecker aus dem Adapter lösen zu können. Da dies mit den Fingern geschieht, ist zwischen den Adaptern Platz nötig, um die Stecker komfortabel handeln zu können.

Das neue tML® HD Patchkabel - Komfortabel in der Handhabung

Das Kernstück des neuen tML® HD Patchkabels bildet der kompakte LC High Density (HD) Stecker. Um diesen Stecker aus dem Adapter zu lösen, genügt ein kurzes Ziehen am integrierten Entriegelungsriemen. Der Riegel nimmt weniger Platz in Anspruch als bei herkömmlichen LC Steckverbindern, dadurch können die Adapter im tML® HD

Modul direkt übereinander "gestapelt" werden. Es ist nicht mehr nötig, Abstände für eine bequeme Handhabung einzukalkulieren und der verfügbare Platz im Modul wird restlos ausgenutzt.

Mit dieser Technologie können in einem tML® Modul statt 6x LC Duplex Ports 12 x LC Duplex Ports realisiert werden, was die Packungsdichte verdoppelt. "Eine höhere Packungsdichte resultiert auch immer in Energie-Einsparungen, da weniger Raum klimatisiert werden muss", erklärt André Engel. Außerdem reduziert der neue tML® HD Stecker die Länge des Steckers gemessen vom Adapter um 15 mm. Die Entriegelungsriemen des Steckers sind in verschiedenen Längen und Farbausführungen erhältlich und können mit Labels oder RFID-Etiketten versehen werden.

Das tML® - tde Modular Link System

tML® ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Es handelt sich dabei um zu 100 Prozent in Deutschland gefertigte, vorkonfektionierte und getestete Systemkomponenten, die vor Ort - insbesondere in Rechenzentren - eine Plug & Play-Installation innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP® und Telco Steckverbinder, über die mindestens 6 Ports mit 10GbE bzw. GbE Performance auf einmal verbunden werden können. Es gibt LWL und TP Module, die zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt eingesetzt werden können.

Portrait

Als international erfolgreich agierendes Unternehmen im Bereich Daten- und Kommunikationstechnik ist die tde - trans data elektronik GmbH auf die Herstellung und Distribution von Netzwerkkomponenten spezialisiert und gilt als technologischer Vorreiter im Bereich der optischen Mehrfasertechnologie. Mit einer äußerst hochwertigen Produktpalette an Kupfer- und Glasfaserapplikationen inklusive der Verteilertechnik bietet der erfahrene Netzwerkexperte Komplettlösungen in den Anwendungsfeldern Datacom, Telecom, Industry und Defence. Zudem bietet die tde als Systemanbieter auch die komplette Planung und Installation von Netzwerken aus einer Hand. Als einer der wenigen deutschen Hersteller von Netzwerkkomponenten unterstützt tde den Code of Conduct für Energieeffizienz in Rechenzentren, eine Initiative der Europäischen Kommission. Weitere Informationen unter: www.tde.de

News-ID: 641528 • Views: 656 (Stand: 04.08.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/641528/tML-HD-Ein-Durchbruch-in-Sachen-Packungsdichte.html>